

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年9月9日 (09.09.2005)

PCT

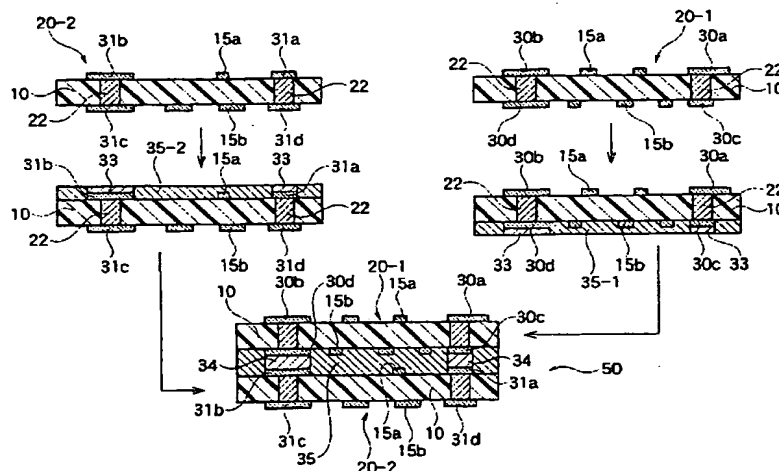
(10) 国際公開番号
WO 2005/084093 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H05K 3/46 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002205 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 林 克彦
(22) 国際出願日: 2005年2月15日 (15.02.2005) (HAYASHI, Katsuhiko) [JP/JP]; 〒3620021 埼玉県上
(25) 国際出願の言語: 日本語 尾市原市 1 3 3 3-2 三井金属鉱業株式会社 総合
(26) 国際公開の言語: 日本語 研究所内 Saitama (JP).
(30) 優先権データ: 特願2004-051554 2004年2月26日 (26.02.2004) JP (74) 代理人: 鈴木 俊一郎 (SUZUKI, Shunichiro); 〒1410031
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三井 東京都品川区西五反田七丁目 1 3 番 6 号 五反田山
金属鉱業株式会社 (MITSUI MINING & SMELTING 崎ビル 6 階 鈴木国際特許事務所 Tokyo (JP).
CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1418584 東京都品川区大崎一
丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP). (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

[続葉有]

(54) Title: MULTILAYER STACKED WIRING BOARD

(54) 発明の名称: 多層積層配線板



(57) Abstract: In a multilayer stacked wiring board, wiring patterns formed of a conductive metal are formed on the both sides of an insulating board. The multilayer stacked wiring board is provided by stacking at least two double sided wiring boards, wherein the wiring patterns formed on the insulating board are connected through a conductive metal of a through hole penetrating the insulating board, and electrical connection is provided between the double sided wiring boards. The double sided wiring boards are electrically connected by connecting low-melting point conductive metal layers arranged on the surfaces of connecting terminals formed on stacking planes of the double sided wiring boards. At least two double sided wiring boards are bonded by a polyimide adhesive resin applied on parts other than the connecting terminal parts on the double sided wiring boards by selective screen printing. In this multilayer stacked wiring board, the multilayer stacked boards are surely stacked and the layers are surely electrically connected.

(57) 要約: 本発明の多層積層配線板は、絶縁基板の両面に導電性金属からなる配線パターンが形成され、該絶縁基板上に形成されたそれぞれの配線パターンが絶縁基板を貫通する貫通孔の導電性金属を介して接続されている両面配線基板を少なくとも2枚積層してなり、かつ各両面配線基板の間に電気的接続を有する多層配線基板であり、それぞれの両面配線基板における積層面に形成された接続端子の表面に配置された

[続葉有]